

苏州国芯科技股份有限公司

关于自愿披露公司研发的汽车电子 MCU 新产品内部测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3007PT”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

一、新产品的基本情况

公司成功研发的汽车电子MCU新产品CCFC3007PT是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核MCU芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。

该芯片基于40nm eFlash工艺开发和生产，相对于同系列的CCFC3008PT芯片，通信LIN增加到16路、MCAN增加到12路，芯片的存储空间Flash容量增加到12M字节，数据存储最高配置Flash最高可达512K字节，内存空间SRAM增加到1536K字节。另外，该芯片优化了SDADC模块及相应的数字滤波模块，使其更适合电机控制，还增加了I2S（2路）用于连接音频设备；CCFC3007PT芯片按照汽车电子Grade1等级、信息安全Evita-Full等级、功能安全ASIL-D等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了产品的应用覆盖面，封装形式包括BGA416/BGA292/LQFP216等，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器，有望为解决我国新能源汽车产业中高端MCU芯片“缺芯”问题作出贡献。目前，该芯片已经给客户送样并开展模组开发和测试。

二、对公司的影响

公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，产品开发阶段就受到国内动力总成、底盘控制器、动力电池控制器和高集成度域控制器模组厂商的关注和支持，已有多家客户开展了模组及系统软件的前期开发。该款新产品的研发成功进一步丰富了公司汽车电子中高端 MCU 产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。

三、风险提示

本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作已经在开展进行中。本次公司推出的汽车电子 MCU 芯片新产品 CCFC3007PT 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日